(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年9月19日(19.09.2024)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2024/190884 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 7/35 (2018.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09J 163/00 (2006.01)
C09J 201/00 (2006.01)
H01L 21/301 (2006.01)
H01L 21/52 (2006.01)
H01L 25/065 (2023.01)
H01L 25/07 (2006.01)
H01L 25/18 (2023.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2024/010087

(22) 国際出願日： 2024年3月14日(14.03.2024)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
PCT/JP2023/010166 2023年3月15日(15.03.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (**RESONAC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 黒田 孝博 (**KURODA Takahiro**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 市川 順一(**ICHIKAWA Junichi**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 細野 慶太(**HOSONO Keita**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 丹羽 孝明(**NIWA Takaaki**); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目９番１号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹，外(**HASEGAWA Yoshiki** et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号丸の内 ＭＹ ＰＬＡＺＡ（明治安田生命ビル） ９階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

(54) Title: FILM ADHESIVE, DICING/DIE BONDING INTEGRATED FILM, AND SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称： フィルム状接着剤、ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム、並びに半導体装置及びその製造方法

(57) Abstract: Disclosed is a film adhesive which contains a thermosetting resin component and an elastomer, and which may additionally contain an inorganic filler. The content of the elastomer is 18% by mass or more based on the total amount of the film adhesive. The content of the inorganic filler is 0-25% by mass based on the total amount of the film adhesive. A cured product obtained by curing the film adhesive under the conditions of 140 °C and 30 minutes has a storage elastic modulus of 80 MPa or more at 150 °C. The film adhesive has a thickness of 15 μm or less.

(57) 要約：熱硬化性樹脂成分と、エラストマーとを含有し、無機フィラーをさらに含有していてもよい、フィルム状接着剤が開示される。エラストマーの含有量は、フィルム状接着剤の全量を基準として、１８質量％以上である。無機フィラーの含有量は、フィルム状接着剤の全量を基準として、０～２５質量％である。フィルム状接着剤を１４０℃、３０分の条件で硬化させたときの硬化物の１５０℃における貯蔵弾性率は、８０ＭＰａ以上である。フィルム状接着剤の厚さは、１５μｍ以下である。

WO 2024/190884 A1

［続葉有］

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国（表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能）：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）